

**2011年度(2012年3月期)**

*FY2011 (March 2012)*

# 決算説明会

*Financial Results & Business Update*



**(証券コード: 6787)**

*(Security Code : 6787)*

**2012年5月22日**

*May 22, 2012*

# 注意事項

## Disclaimer

---

本資料には過去の事実以外に今後の業績見通し等の計画・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの見通しは過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成した見通しです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は見通しと異なる場合がございます。

*This presentation contains forward-looking statements concerning Meiko Group's future plans, strategies and performance. However, Meiko does not publish this presentation as a disclosure document based on the Financial Instruments and Exchange Act of Japan.*

*These forward-looking statements are not historical facts, rather they represent assumptions and beliefs based on comprehensive data currently available.*

*Furthermore, the PCB business is subject to a number of risks and uncertainties that relate to raw material price, conditions of customers' market, technological trends, foreign currency exchange rates, tax rules, regulations, disasters, international conflicts and other factors. Meiko therefore wishes to caution that actual results may differ materially from our expectations.*

# 1. 2011年度 決算概要

*Summary of FY2011*

	Page
1－ 1. 2011年度実績の概況 <i>Outline of FY2011 Results</i>	3
1－ 2. 連結決算実績 (2010年度・2011年度) <i>Consolidated Financial Results</i>	4
1－ 3. 単独決算実績 (2010年度・2011年度) <i>Non-Consolidated Financial Results</i>	5
1－ 4. 主な関連部門決算(広州・武漢・山形) <i>Major Sections Results</i>	6
1－ 5. 営業利益 前年度比較 <i>Operating Income (VS. FY2009)</i>	7
1－ 6. 売上高(事業種類別) <i>Net Sales (by business)</i>	8
1－ 7. 売上高(アプリケーション別) <i>Net Sales (by market)</i>	9
1－ 8. 売上高(品目別) <i>Net Sales (by products)</i>	10
1－ 9. 設備投資 <i>Capital Investments</i>	11
1－ 10. Cash Flow <i>Cash Flow</i>	12
1－ 11. 貸借対照表・自己資本比率 <i>B/S &amp; Equity Ratio</i>	13
1－ 12. ROE・ROA・有利子負債 <i>ROE・ROA・Interest Bearing Debt</i>	14
1－ 13. 福島工場復興経緯 <i>Recovery Process of Fukushima Plant</i>	15

# 1-1. 2011年度実績の概況

Outline of FY2011 Results

## 連結実績

Consolidated Results

■売上高 <i>Net Sales</i>	62,972百万円 <i>¥ millions</i>	前年同期比 -15.7% <i>Year to Year</i>
■営業利益 <i>Operating Income</i>	812百万円 <i>¥ millions</i>	前年同期比 -75.4% <i>Year to Year</i>

## プラス要因(前年比)

Positive factor

- 国内ビジネスの好況  
*Prosperity in the domestic business*
- 車載ビジネスの拡大  
*Expansion of the automobiles business*

## マイナス要因(前年比)

Negative factor

- 武漢第二工場の稼働停止  
*Suspension of the 2<sup>nd</sup> factory of Wuhan Plant*
- TV用基板の不調  
*Depression of the PCB for TV*

# 1-2. 連結決算

## Consolidated Financial Results

(百万円 ¥Million)

	FY 2010	前年比 (YoY)	FY2011	前年比 (YoY)
<b>売上高</b> Net Sales	74,724	7.0%	62,972	-15.7%
<b>営業利益</b> Operating Income	3,297	-13.1%	812	-75.4%
<b>営業利益率</b> Operating Income Ratio	4.4%		1.3%	
<b>経常利益</b> Ordinary Income	2,127	-21.1%	222	-89.6%
<b>経常利益率</b> Ordinary Income Ratio	2.8%		0.4%	
<b>当期純利益</b> Net Income	-3,094	-	1,158	-
<b>当期純利益率</b> Net Income Ratio	-4.1%		1.8%	
<b>1株当たり当期純利益</b> Net Income(loss) per share(yen)	-166.32円		61.73円	

# 1-3. 单独決算

Non-Consolidated Financial Results

(百万円 ¥Million)

	FY2010	前年比 (YoY)	FY2011	前年比 (YoY)
<b>売上高</b> Net Sales	44,634	3.5%	33,802	-24.3%
<b>営業利益</b> Operating Income	2,661	619.1%	2,569	-3.5%
<b>営業利益率</b> Operating Income Ratio	6.0%		7.6%	
<b>経常利益</b> Ordinary Income	1,822	116.5%	2,204	21.0%
<b>経常利益率</b> Ordinary Income Ratio	4.1%		6.5%	
<b>当期純利益</b> Net Income	-2,909	-	3,677	-
<b>当期純利益率</b> Net Income Ratio	-6.5%		10.9%	
<b>1株当たり当期純利益</b> Net Income(loss) per share(yen)	-156.35円		195.89円	

# 1-4. 主な関連部門 決算

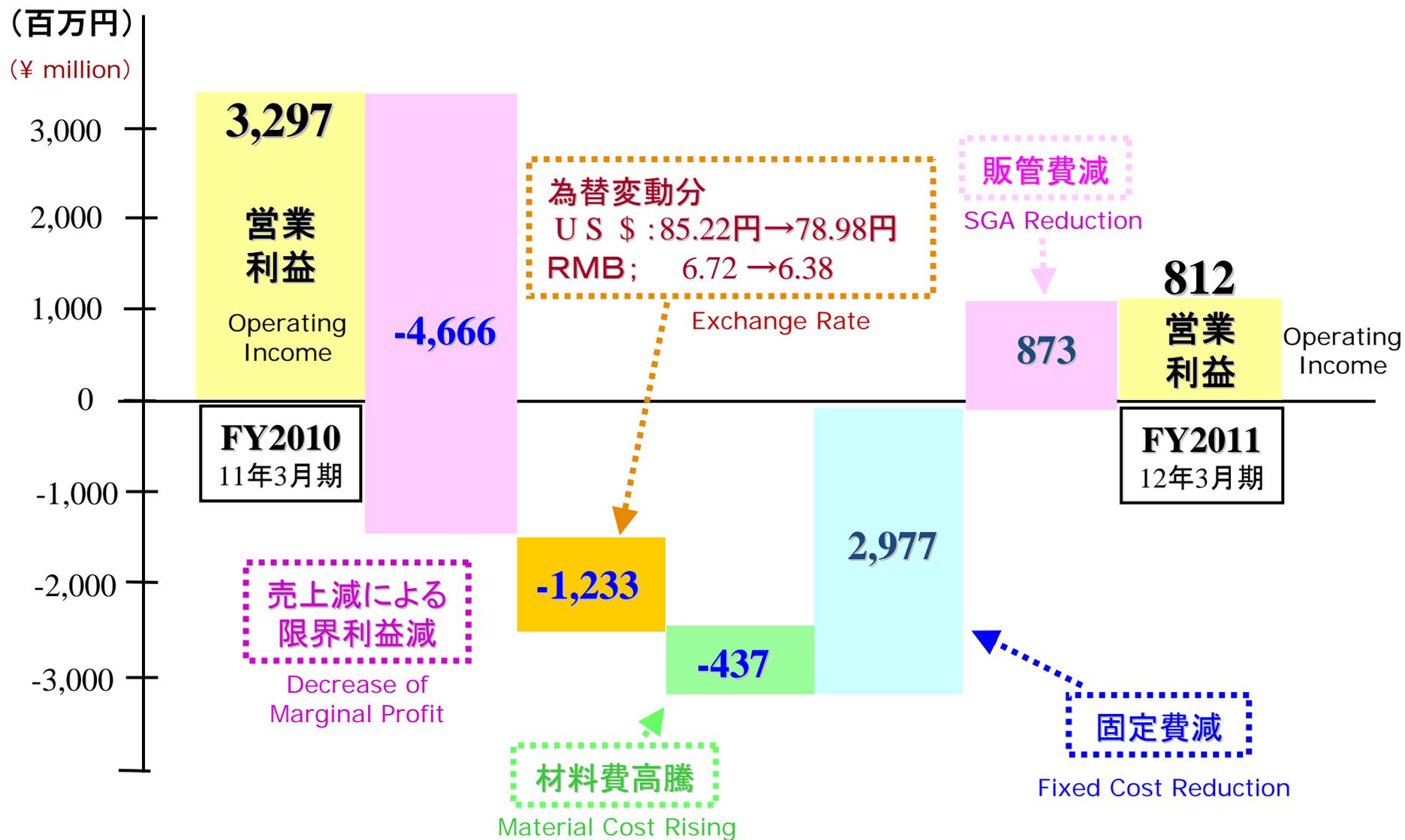
## Major Sections Results

(百万円 ¥Million)

主要工場 Main Plant		FY2010	前年比(YoY)	FY2011	前年比(YoY)
GuangZhou Plant					
広 州	売上高 Net Sales	31,132	11.9%	28,383	-8.8%
	営業利益 Operating Income	1,310	-50.8%	960	-26.7%
	営業利益率 Operating Income Ratio	4.2%		3.4%	
Wuhan Plant					
武 漢	売上高 Net Sales	25,798	20.9%	19,024	-26.3%
	営業利益 Operating Income	2,150	-24.6%	-548	-
	営業利益率 Operating Income Ratio	8.3%		-2.9%	
Yamagata Plant					
山 形	売上高 Net Sales	6,691	0.2%	7,758	15.9%
	営業利益 Operating Income	144	-	539	274.3%
	営業利益率 Operating Income Ratio	2.2%		7.0%	

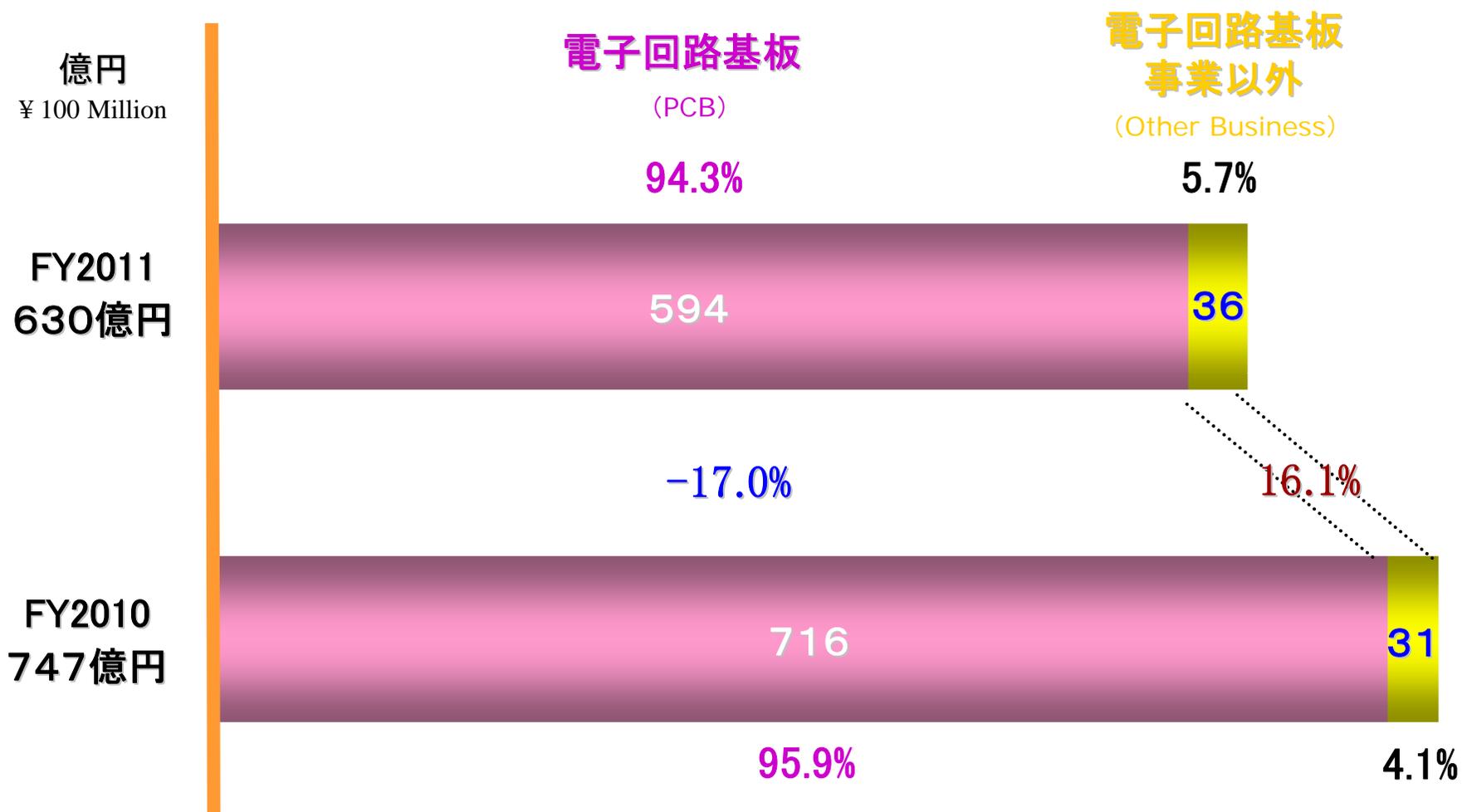
# 1-5. 営業利益 前年比較

Operating Income vs. FY2010



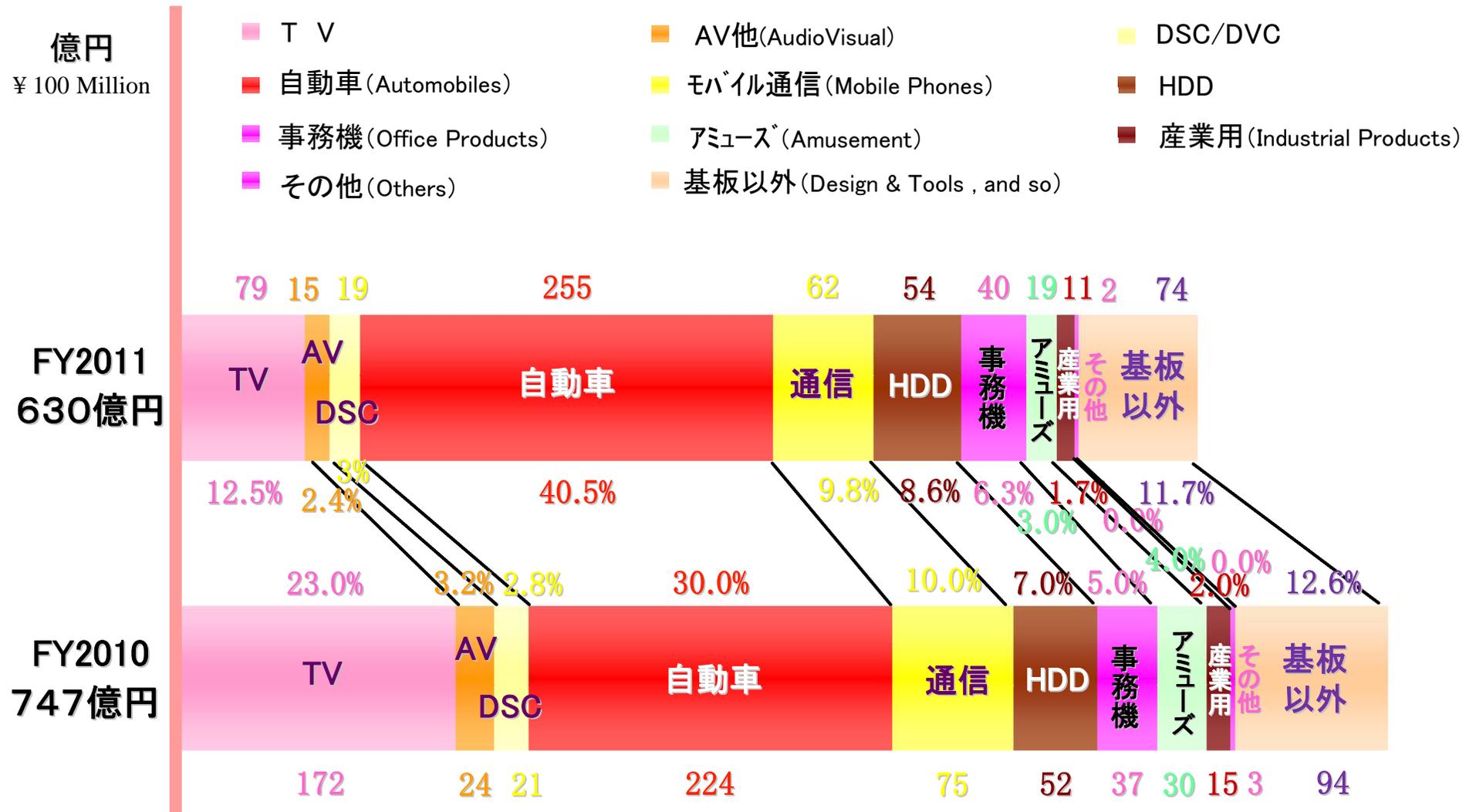
# 1-6. 売上高(事業の種類別)

Net Sales by business



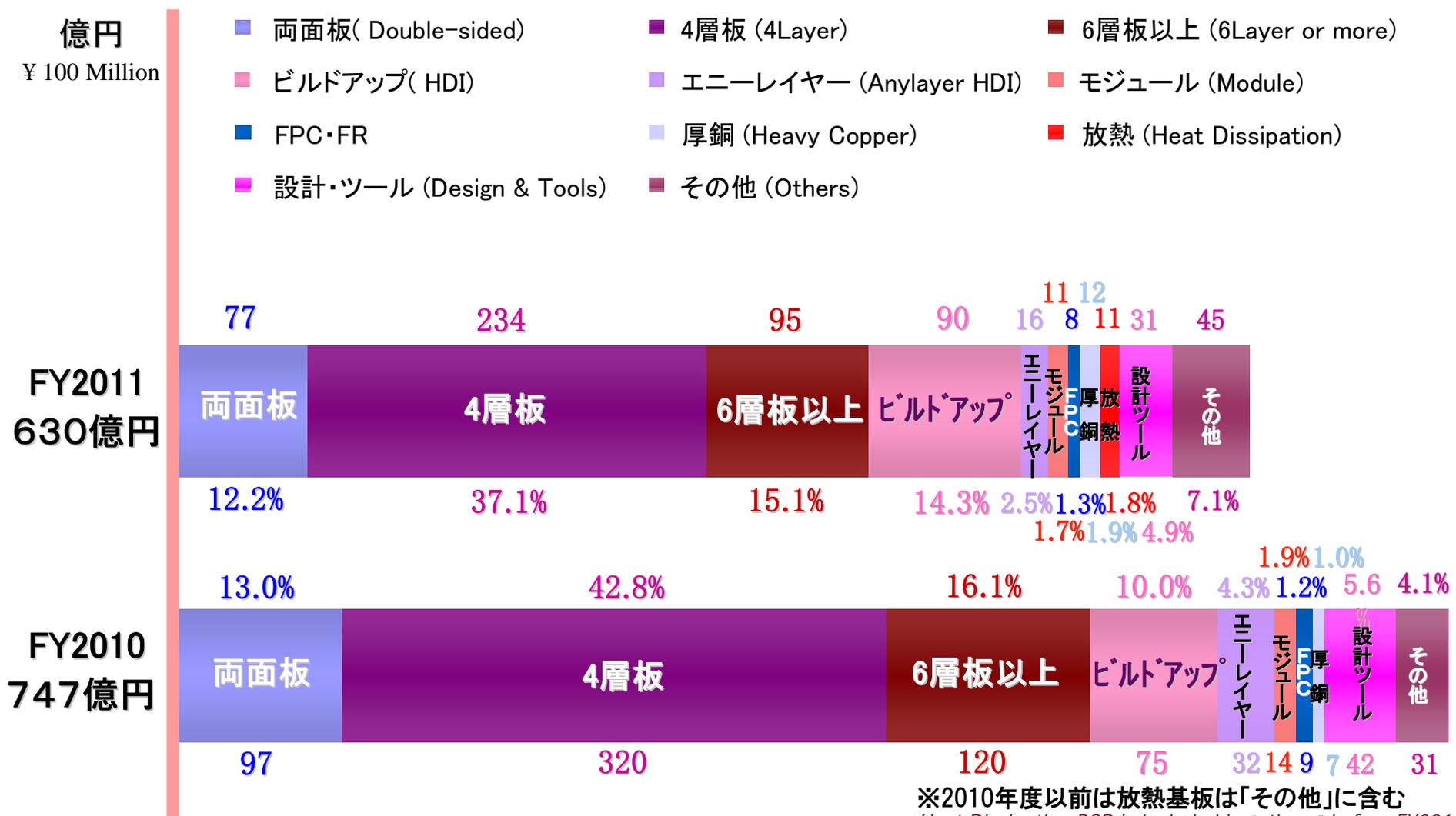
# 1-7. 売上高(アプリケーション別)

Net Sales by market



# 1-8. 売上高(品目別)

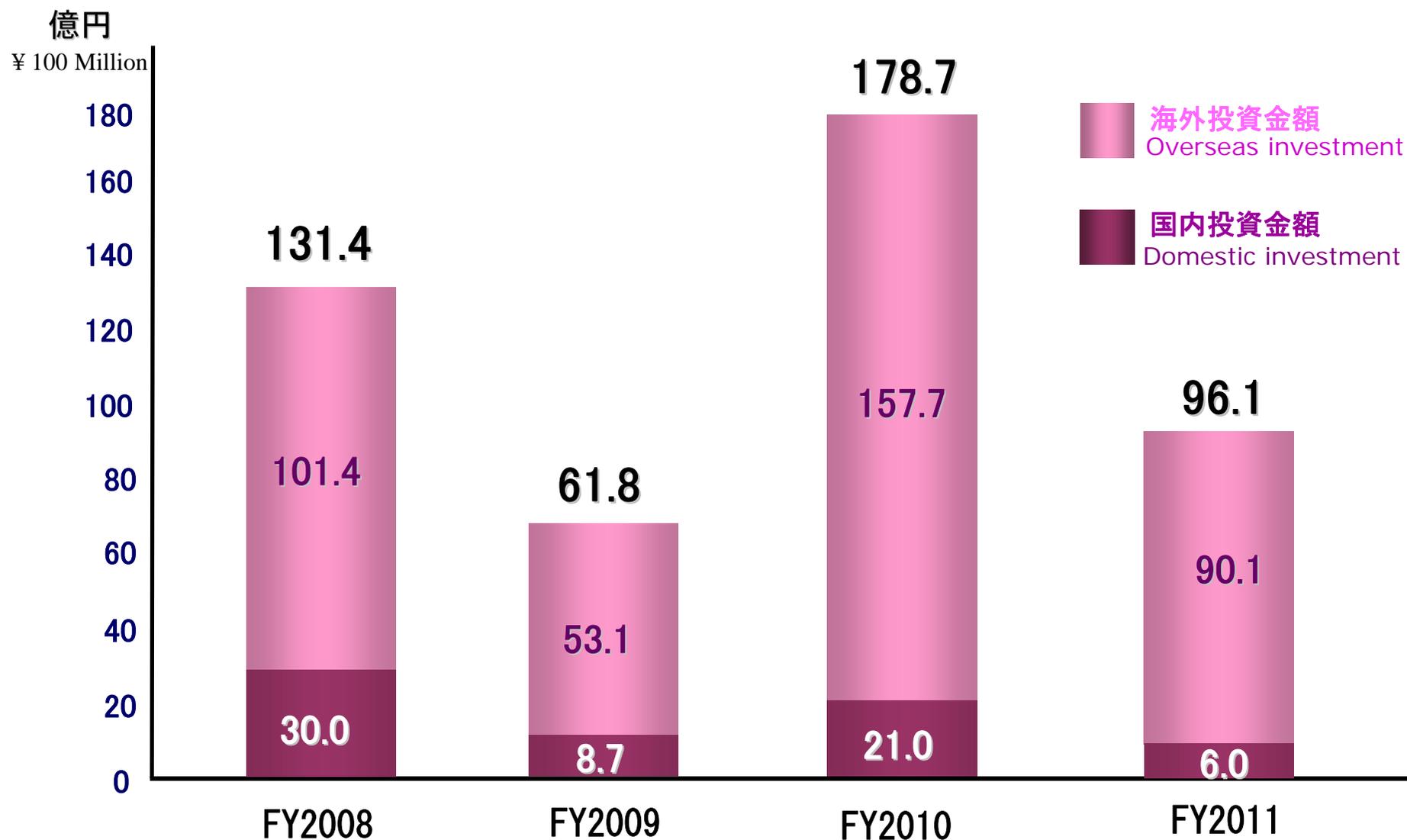
Net Sales by products



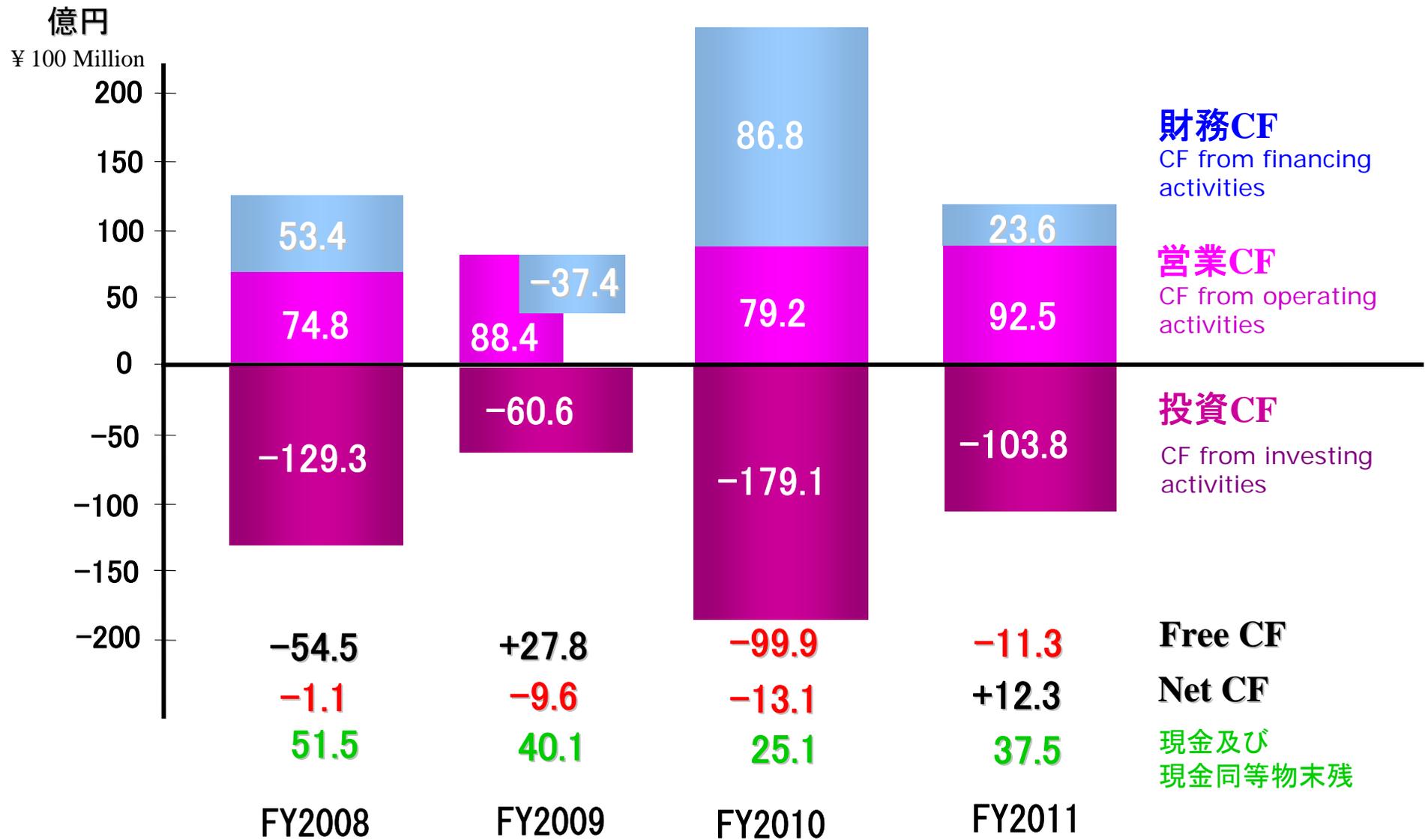
※2010年度以前は放熱基板は「その他」に含む  
Heat Dissipation PCB is included in "others" before FY2011

# 1-9. 設備投資実績推移

Capital Investments

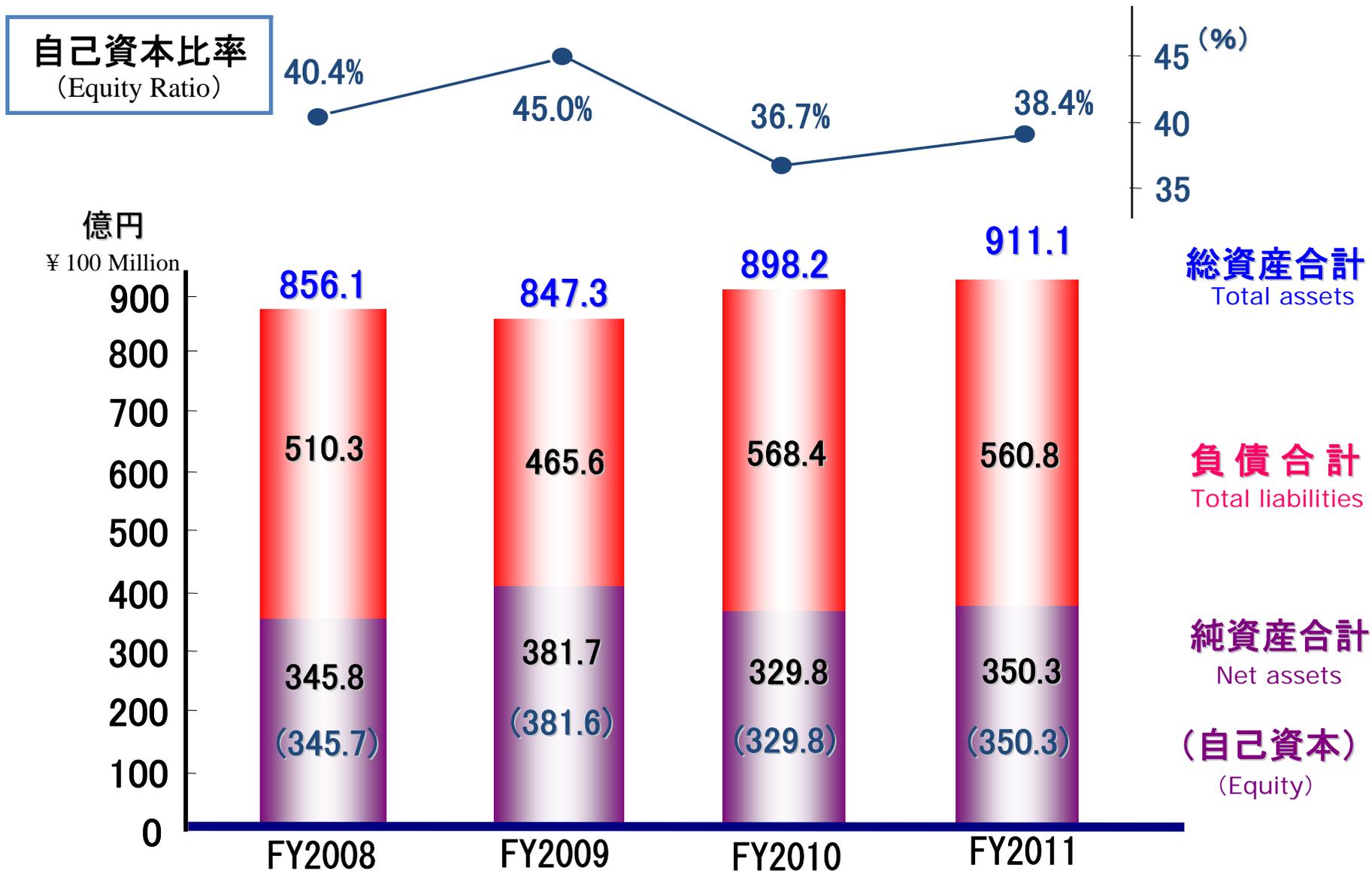


# 1-10. Cash Flow



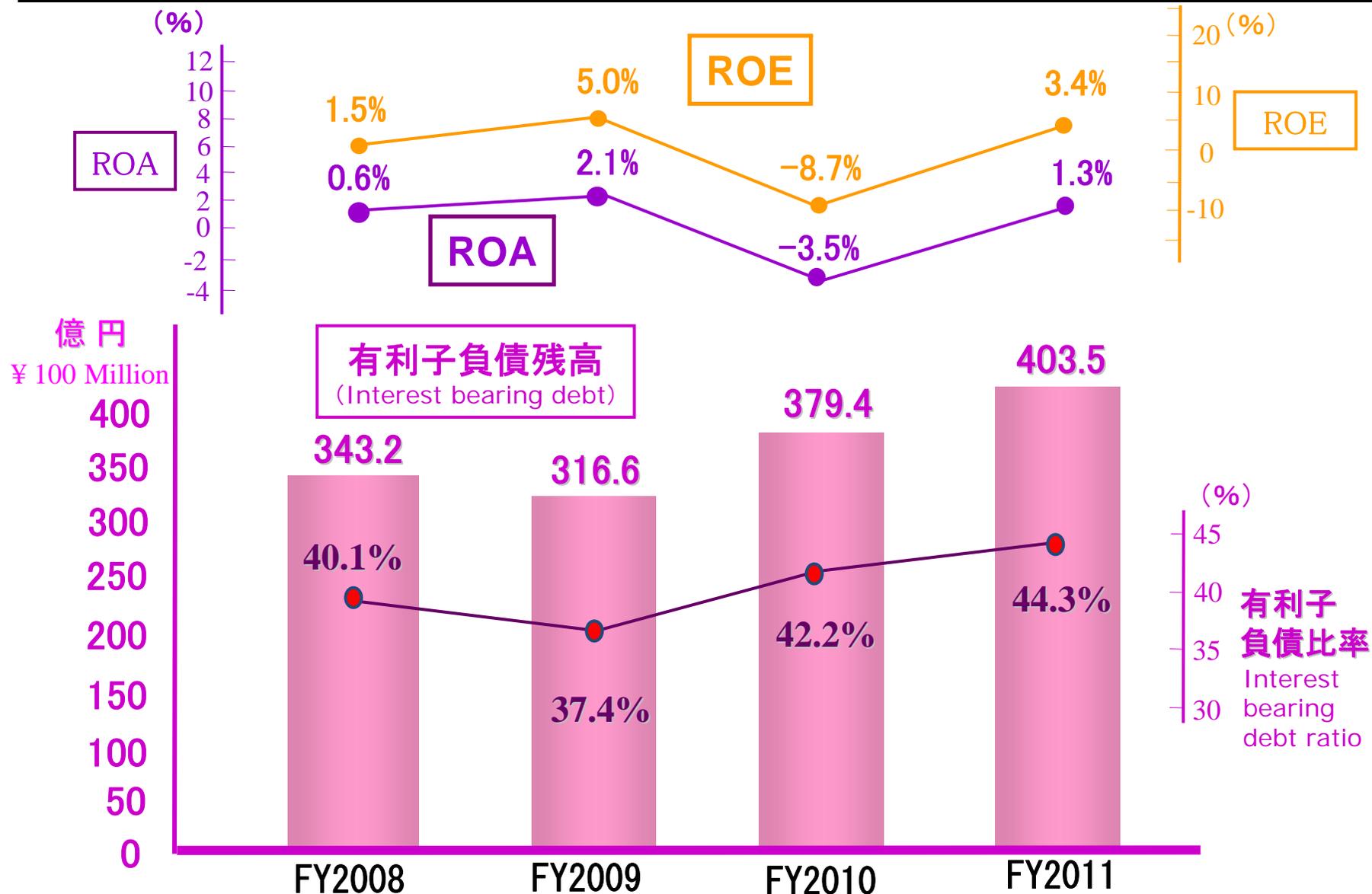
# 1-11. 貸借対照表・自己資本比率

B/S & Equity Ratio



# 1-12. ROE・ROA・有利子負債

ROE・ROA・Interest Bearing Debt



# 1-13. 福島工場復興経緯

## Recovery Process of Fukushima Plant

2011

3/11 東日本大震災発生

工場稼働停止

The Great East Japan Earthquake occurred.  
Stopped operation of Meiko Fukushima Plant

3号機水素爆発



3/12 第一原発20km圏内住民に  
避難指示

Evacuation order issued for residents within 20km from  
the 1<sup>st</sup> power plant.

3/25 同20-30km圏内に拡大

Evacuation order expanded from 20km to 30km.

4/21 半径20km圏内が警戒区域に指定

Designation of caution zones(20km) by government

4/23 20kmを計画的避難区域、30kmを緊急時避難準備  
区域と設定

Designation of planned evacuation zones(20km), and emergency  
evacuation preparation zones(30km) by government.

4/25 福島工場復旧スタート

Started recovery project of Meiko Fukushima Plant.

7/1 本格的生産開始

Started full-production Meiko Fukushima Plant.

9/30 緊急時避難準備区域を解除

Cancellation of emergency evacuation preparation zones.

2012 3/15 東京電力より賠償金7億4300万が支払われる。

Received 743 million JPY in compensation for damages  
from TEPCO.



## 2. 2012年度(2013年3月期)の通期見通し

*FY2012 Prospects*

	Page
2- 1. 2012年度見通しの概況 <i>Summary of FY2012 Prospects</i>	17
2- 2. 連結決算 見通し <i>Consolidated Forecast</i>	18
2- 3. 単独決算 見通し <i>Non-Consolidated Forecast</i>	19
2- 4. 主な関連部門 見通し <i>Major Sections Forecast</i>	20
2- 5. 営業利益見通し 前年比較 <i>Operating Income Forecast vs. FY2011</i>	21
2- 6. 売上高(事業の種類別) <i>Net Sales by business</i>	22
2- 7. 売上高(アプリケーション別) <i>Net Sales by market</i>	23
2- 8. 売上高(品目別) <i>Net Sales by products</i>	24
2- 9. 売上高(地域別) <i>Net Sales by regions (PCB only)</i>	25
2-10. 設備投資予定 <i>Capital Investments Plan</i>	26

## 2-1. 2012年度見通しの概況

*Summary of FY2012 Forecast*

### 連結実績

*Consolidated Results*

- **売上高** 72,000百万円 前期比 +14.3%  
*Net Sales* ¥ millions Year to Year
- **営業利益** 2,600百万円 前期比 +220.1%  
*Operating Income* ¥ millions Year to Year

### プラス要因(前年比)

*Positive factor*

- **ベトナム工場の本格稼働**  
*Start of full-production on the Vietnam plant*
- **武漢第二工場の稼働率アップ**  
*Rise of operating ratio on the 2<sup>nd</sup> factory of Wuhan Plant*

### マイナス要因(前年比)

*Negative factor*

- **TV基板の落ち込み**  
*Depression of the PCB for TV*

## 2-2. 連結決算 見通し

Consolidated Forecast

想定レート: ¥81.0 / US\$ 6.17RMB/US\$

Foreign exchange rate assumption

(百万円 ¥Million)

	FY2010	前年比 (YoY)	FY2011	前年比 (YoY)	FY2012	前年比 (YoY)
<b>売上高</b> Net Sales	74,724	7.0%	62,972	-15.7%	72,000	14.3%
<b>営業利益</b> Operating Income	3,297	-13.1%	812	-75.4%	2,600	220.1%
<b>営業利益率</b> Operating Income Ratio	4.4%		1.4%		3.6%	
<b>経常利益</b> Ordinary Income	2,127	-21.1%	222	-89.6%	1,500	575.3%
<b>経常利益率</b> Ordinary Income Ratio	2.8%		0.5%		2.1%	
<b>当期純利益</b> Net Income	-3,094	-	1,158	-	350	-69.8%
<b>当期純利益率</b> Net Income Ratio	-4.1%		1.8%		0.5%	
<b>1株当たり当期純利益</b> Net Income(loss) per share(yen)	-166.32円		61.73円		18.64円	

## 2-3. 単独決算 見通し

Non-Consolidated Forecast

想定レート: ¥81.0 / US\$ 6.17RMB/US\$  
Foreign exchange rate assumption

(百万円 ¥Million)

	FY2010	前年比(YoY)	FY2011	前年比(YoY)	FY2012	前年比(YoY)
<b>売上高</b> Net Sales	44,634	3.5%	33,802	-24.3%	34,000	0.6%
<b>営業利益</b> Operating Income	2,661	619.1%	2,569	-3.5%	2,050	-20.2%
<b>営業利益率</b> Operating Income Ratio	6.0%		7.6%		6.0%	
<b>経常利益</b> Ordinary Income	1,822	116.5%	2,204	21.0%	1,750	-20.6%
<b>経常利益率</b> Ordinary Income Ratio	4.1%		6.5%		5.1%	
<b>当期純利益</b> Net Income	-2,909	-	3,677	-	1,050	-71.4%
<b>当期純利益率</b> Net Income Ratio	-6.5%		10.9%		3.1%	
<b>1株当たり当期純利益</b> Net Income(loss) per share(yen)	-156.35円		195.89円		55.93円	

## 2-4. 主な関連部門 見通し

### Major Sections Forecast

想定レート: ¥81.0 / US\$ 6.17RMB/US\$

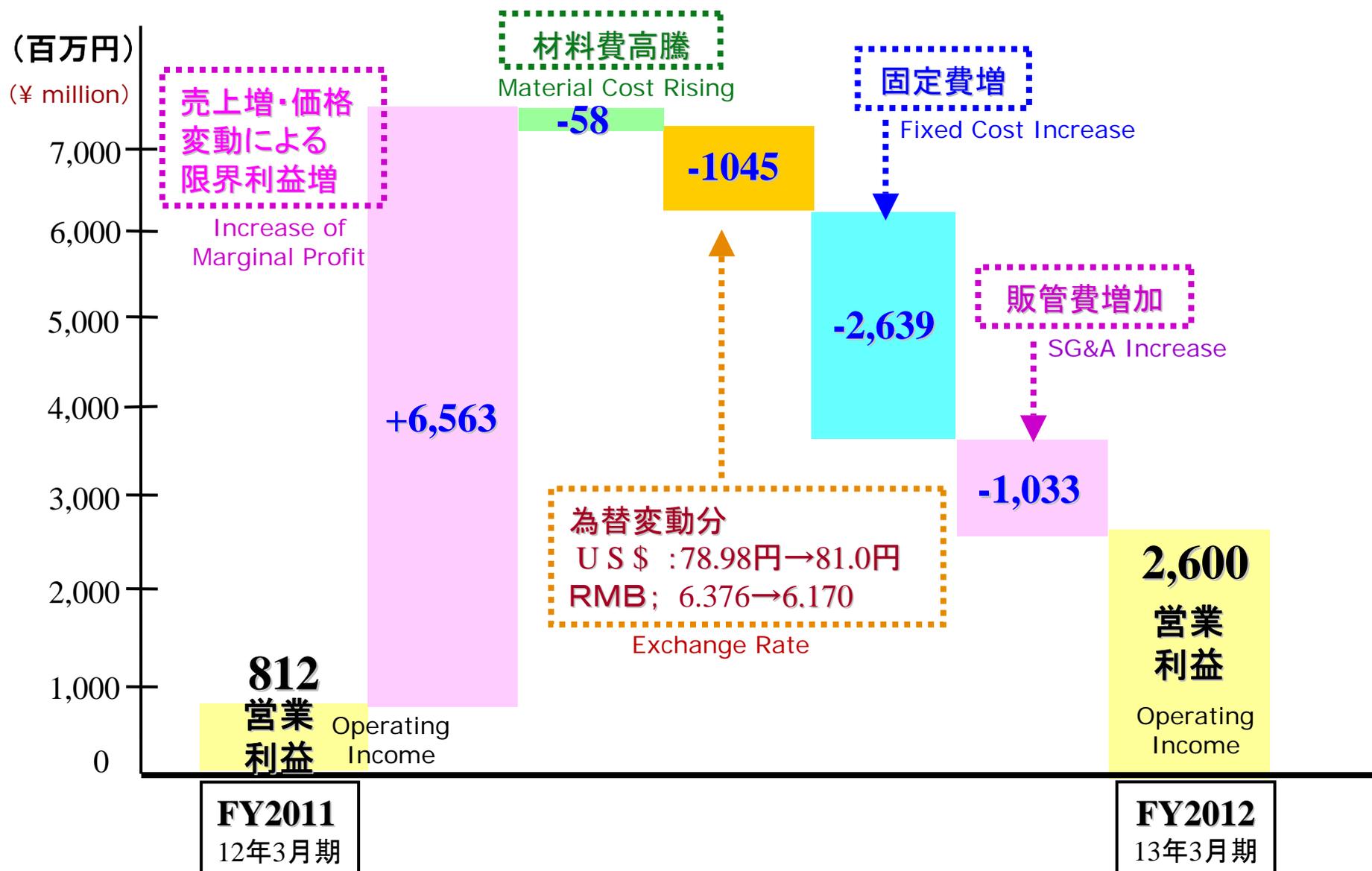
Foreign exchange rate assumption

(百万円 ¥Million)

主要工場(Main Plant)		FY2010	前年比(YoY)	FY2011	前年比(YoY)	FY2012	前年比(YoY)
GuangZhou Plant							
広 州	売上高 Net Sales	31,132	11.9%	28,384	-8.8%	28,957	2.0%
	営業利益 Operating Income	1,311	-50.8%	961	-26.7%	1,511	57.2%
	営業利益率 Operating Income Ratio	4.2%		3.4%		5.2%	
Wuhan Plant							
武 漢	売上高 Net Sales	25,798	20.9%	19,024	-26.3%	24,542	29.0%
	営業利益 Operating Income	2,150	-24.2%	-549	-	302	-
	営業利益率 Operating Income Ratio	8.3%		-2.9%		1.2%	
Vietnam Plant							
ベ ト ナ ム	売上高 Net Sales	-	-	840	-	5,637	571.1%
	営業利益 Operating Income	-		-757	-	104	-
	営業利益率 Operating Income Ratio	0.0%		-90.1%		1.9%	

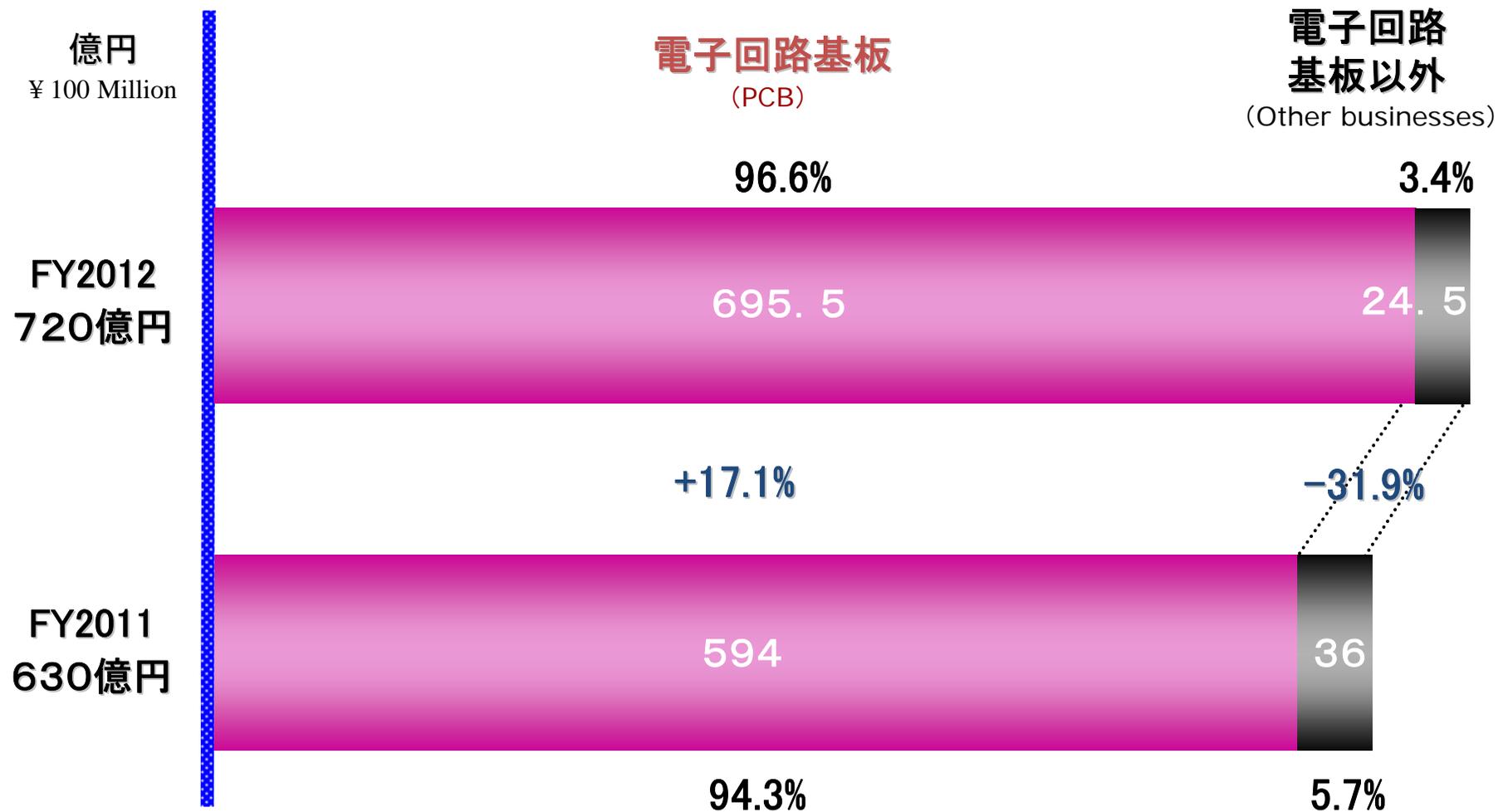
## 2-5. 営業利益見通し 前年比較

Operating Income Forecast vs. FY2011



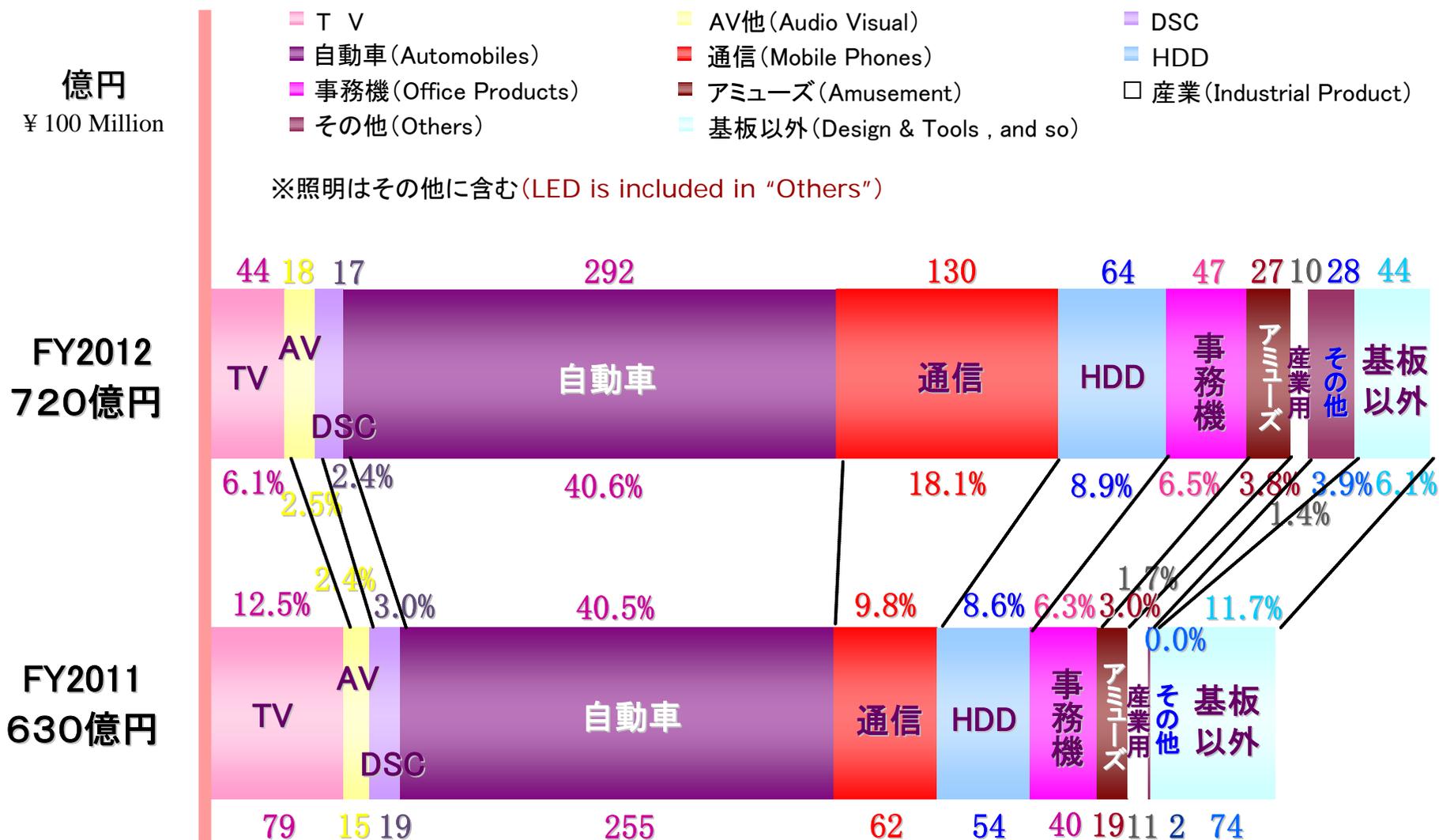
## 2-6. 売上高(事業の種類別)

Net Sales by business



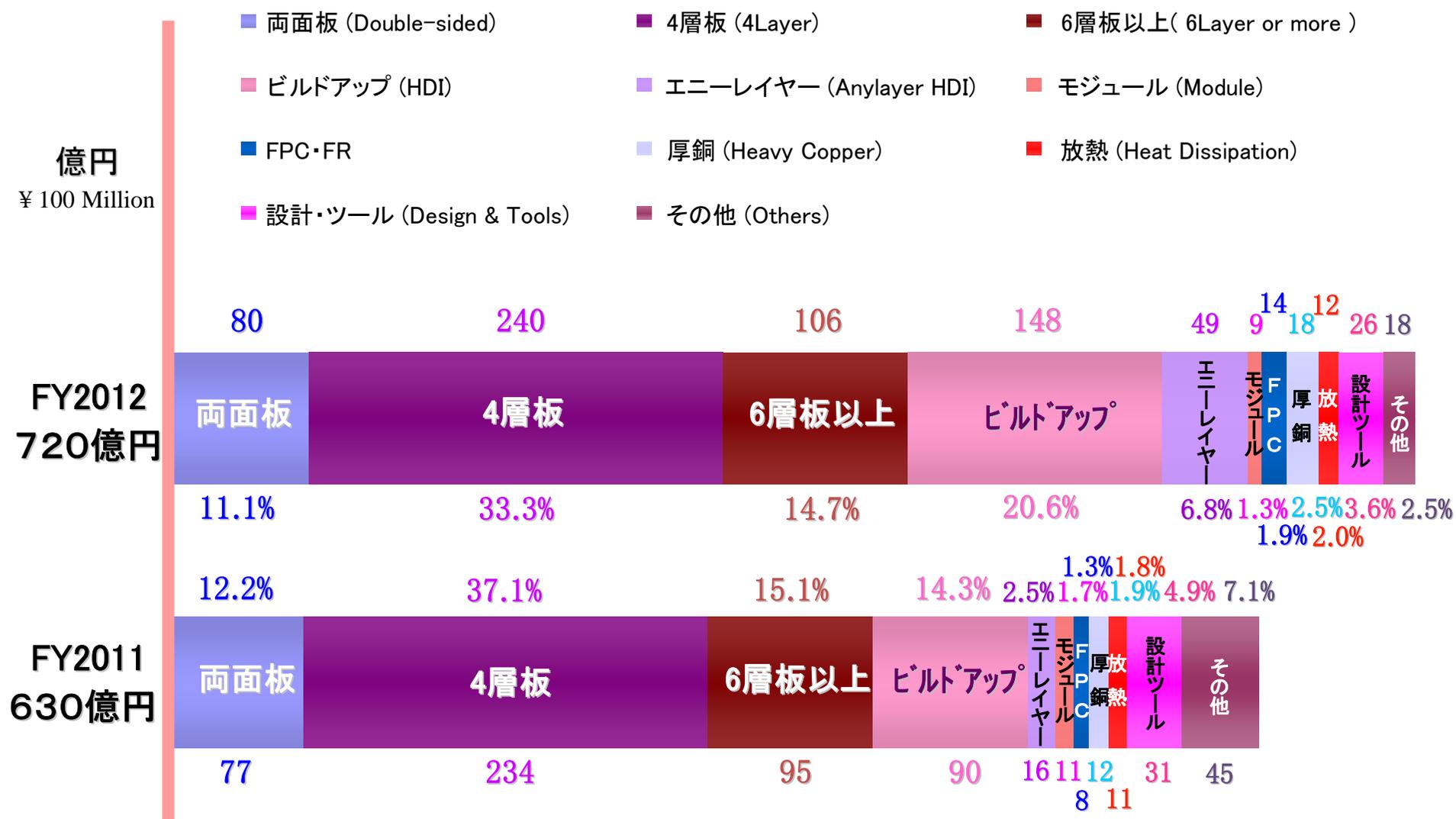
## 2-7. 売上高(アプリケーション別)

Net Sales by market



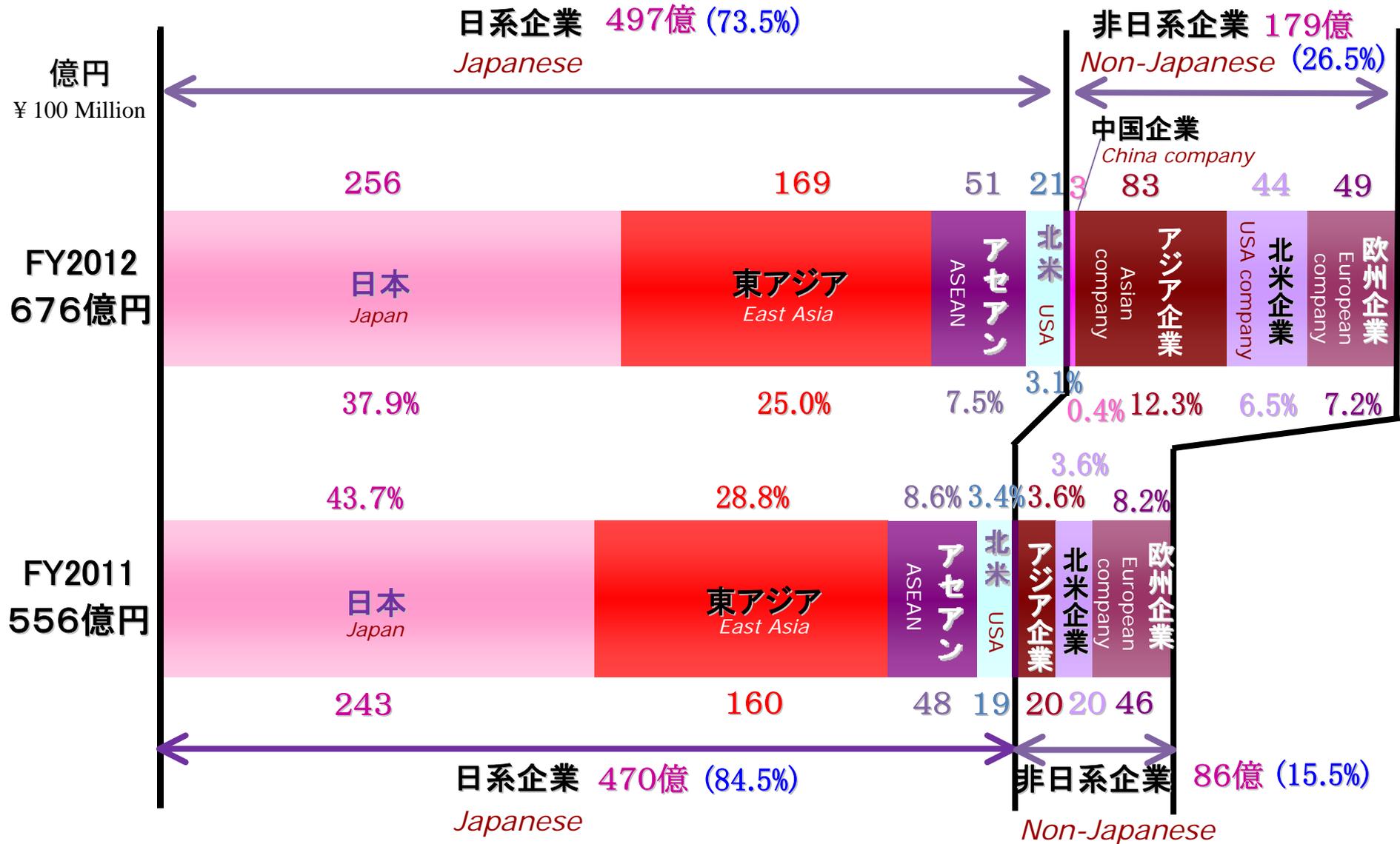
## 2-8. 売上高(品目別)

Net Sales by products



## 2-9. 売上高(地域別、基板のみ)

Net Sales by regions



## 2-10. 2012年度設備投資予定

### Capital Investments Plan

	設備投資 <i>(Capital investment)</i>	主な投資内容 <i>(Details)</i>
国内 <i>(Domestic)</i>	5億円 <i>(0.5 billion JPY)</i>	新商品・品質・環境 研究開発 保全 <i>New Products , Quality Improvement Environmental Equipments ・ R&amp;D</i>
海外 <i>(Overseas)</i>	45億円 <i>(4.5 billion JPY)</i>	広州 車載・品質・環境 武漢 新商品 ベトナム 増設・新ライン <i>Guangzhou : Automobiles/Quality/Environment Wuhan : New products Vietnam : Facilities/New Production Line</i>
合計 <i>(Total)</i>	50億円 <i>(5 billion JPY)</i>	

注) 宮城工場復興投資は来年度投資(一部公的資金も含む)

*Investment for the resumption of Miyagi Plant will be done next fiscal year.  
(including capital from public sources)*

### 3. 2012年度(2013年3月期)の取り組み

*FY2012 Action Plan*

	Page
3- 1. 2012年度の取り組み <i>FY2012 Action Plan</i>	28
3- 2. 宮城工場 再開計画 <i>Resumption Plan of the Miyagi Plant</i>	29
3- 3. 広州工場 重点施策 <i>Initiative of the Guangzhou Plant</i>	30
3- 4. 武漢工場 重点施策 <i>Initiative of the Wuhan Plant</i>	31
3- 5. ベトナム工場 重点施策 <i>Initiative of the Vietnam Plant</i>	32
3- 6. 事業拡大戦略(1)厚銅基板 <i>Business expansion Strategy(1) - High Electric Current PCB</i>	33
3- 7. 事業拡大戦略(2)部品内蔵基板 <i>Business expansion Strategy(2) - Embedded Devices PCB</i>	34

## 3-1. 2012年度の取り組み

*FY2012 Action Plan*

---

### ☆海外事業

*Overseas Business*

- ・ベトナム工場の本格稼働  
*Starting of full-production of the Vietnam Plant*
- ・中国工場からベトナム工場への設備移管  
*Transfer of some equipments from China to Vietnam*
- ・中国市場開拓・アジア市場拡大  
*Expansion of the Chinese market & Asia Business*
- ・欧米事業の拡大  
*Expansion of the US market & Europe Business*

### ☆国内事業

*Domestic Business*

- ・宮城工場の再開準備  
*Prepare for resumption of Miyagi Plant*
- ・新規開発基板の立上  
*Starting for the new R&D Products*

## 3-2. 宮城工場 再開計画

*Resumption Plan of the Miyagi Plant*

### ■再開予定時期 *Resumption target*

本年度中に稼働の準備を開始し、来年度に操業を再開する  
*Prepare for resumption this year  
and start operation next fiscal year.*

### ■コンセプト *Concept*

新工法による最先端パイロットプラント  
*The cutting edge pilot plant through the new manufacturing method.*

### ■製品内容

1. 新工法 モジュール基板  
*New method Module PCB*
2. 新工法 厚銅基板  
*New method High Electric Method Current PCB*
3. 新工法 部品内蔵基板  
*New method Embedded Devices PCB*



### 3-3. 広州工場 重点施策

*Initiative of the Guangzhou Plant*

#### ◆車載専用工場に向けての高信頼性の確立◆

*Establishing the high reliability for the automobile-centered plant.*

⇒不良ゼロ、生産性向上、高品質、低L.T.、在庫圧縮

*Zero defect, improvement of productivity and quality,  
shortening of lead time, reduction of inventory.*

#### ◆一部設備のベトナム工場への移設◆

*Transferring some equipments to Vietnam Plant.*



## 3-4. 武漢工場 重点施策

*Initiative of the Wuhan Plant*

### ◆第1工場◆ *1<sup>st</sup> Factory*

⇒TV中心工場からの脱却、車載基板・HDD基板拡大

SSD基板の本格生産、新規分野の検討

*Shifting from the TV-centered factory to Automobile and HDD.*

*Full-production of PCB for SSD. Exploring the new market.*

### ◆第2工場◆ *2<sup>nd</sup> Factory*

⇒HDI基板(スマートフォン、デジタル一眼レフetc.)・

厚銅基板、放熱基板の事業拡大

*Expanding the HDI-PCB for smart-phones & DSC, high electric current PCB, and heat dissipation PCB.*

### ◆一部設備のベトナム工場への移設◆

*Transferring some equipments to Vietnam Plant.*



## 3-5. ベトナム工場 重点施策

*Initiative of the Vietnam Plant*

### ◆対中国比生産性30%アップ◆

*Improving productivity by 30% compared to plants in China.*

### ◆スマートフォン・携帯電話用HDI基板◆

*HDI-PCBs for smart-phone and mobile phone.*

### ◆車載用貫通基板◆

*PCB for the Automobile*

### ◆FPC基板◆

*Flexible PCB*



## 3-6. 事業拡大戦略(1) - 厚銅基板

*Business expansion strategy – High Electric Current PCB*

### ■厚銅基板と市場 *High Electric Current PCB and market*

主に車載品(エンジンルーム)や太陽光発電など、大量の電気をを用いるアプリケーションに対し使用される高電流対応を必要とする基板。ハイブリッドカー、スマートグリッド、高出力電動機器、産業機器など成長が期待できる市場が多い。

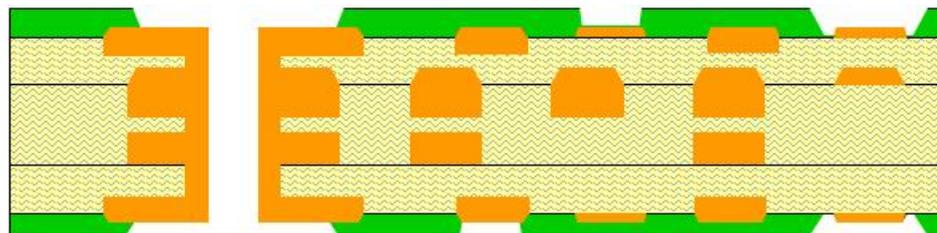
*Required for applications that deal with high electric current such as automobiles(engine room) and solar-power system. Many markets, such as hybrid cars, smart grids, ultra high power electronics, and industrial equipments, are expected further growth.*

### ■基板仕様 *PCB Specification*

通常工法の厚銅基板では  
50~130 $\mu$ mの銅厚になるが、

大電流に対応する為には更に回路の断面積を大きくする必要がある。そこで、メイコーは150~400 $\mu$ mの厚い回路を形成し、特殊工法で製造する。

*The 50~130 $\mu$ m pattern thickness, which is formed by the common process of heavy copper PCB, is not thick enough to deal with ultra high electric current. Meiko's special manufacturing method enables to form as much as 150~400 $\mu$ m pattern thickness.*



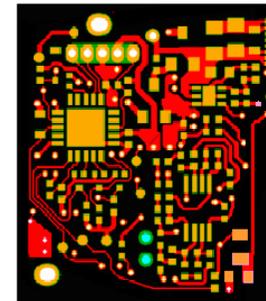
## 3-7 事業拡大戦略(2) - 部品内蔵基板

*Business expansion strategy - Embedded Devices PCB*

### ■部品内蔵基板と市場 *Embedded Devices PCB and market*

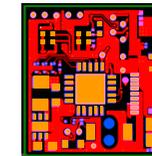
スマートフォンの高機能化に伴い、モジュール基板の小型化が要求されている。そこで、実装部品をあらかじめ基板内部に入れることにより、小型化が実現され、バッテリーが大きくできるなどのメリットが生じる。

*As smart-phones getting more sophisticated, module PCBs are required smaller and smaller. Miniaturization of PCB is realized by embedding surface mount devices inside PCB, thereby enlarging the batteries.*



SIZE: 477mm<sup>2</sup>

面積比 50%削減  
50% cut on dimensions



SIZE: 240mm<sup>2</sup>

### ■メイコーの部品内蔵基板 *Originalities*

- ・チップ部品(抵抗・コンデンサ・半導体)内蔵により機器の小型化に貢献

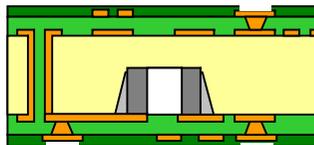
*Contributing to smaller equipment dimensions by embedding chip components(resistors & condensers).*

- ・表面実装ICと内蔵部品との配線長短縮化により電気特性向上

*Improving the electrical properties by shortening wiring distance between surface-mount IC and embedded device.*

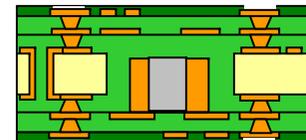
- ・アプリケーションにより最適な部品接続方法(はんだ接続/銅めっき接続)を提案

*Suggesting the best connection solder or plate according to applications.*



4層 はんだ  
接続構造

*4 Layer Solder Connection*



6層 めっき  
接続構造

*6 Layer Plate Connection*

## 4. 中期経営計画

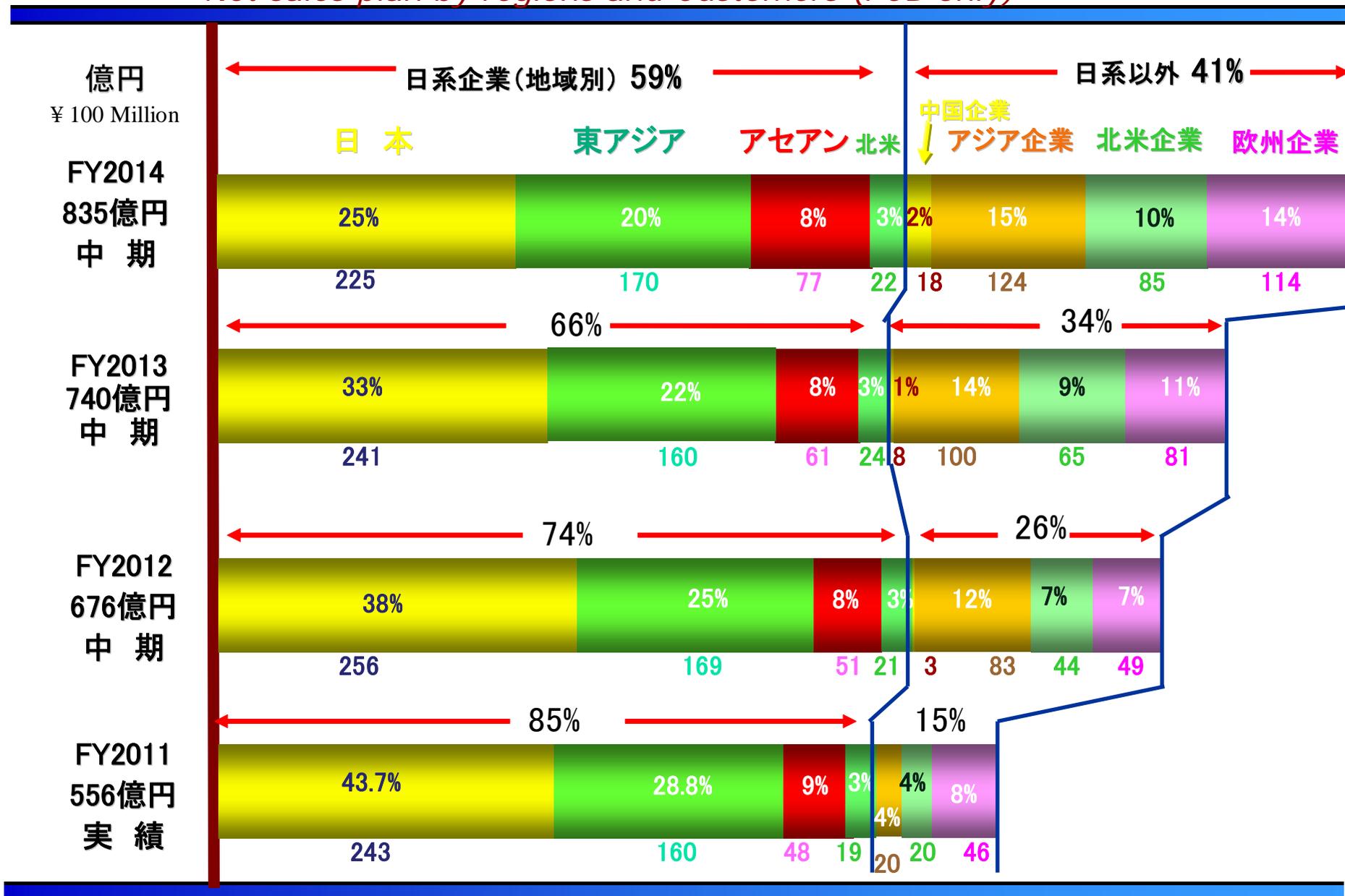
*Mid-term Management Plan*

---

	Page
4－ 1. 顧客別・地域別売上計画(基板のみ) <i>Net sales plan by regions and Customers (PCB only)</i>	36
4－ 2. 基板工場別売上高計画 <i>Net sales plan by production sites</i>	37
4－ 3. 設備投資中期計画 <i>Capital Investments plan</i>	38

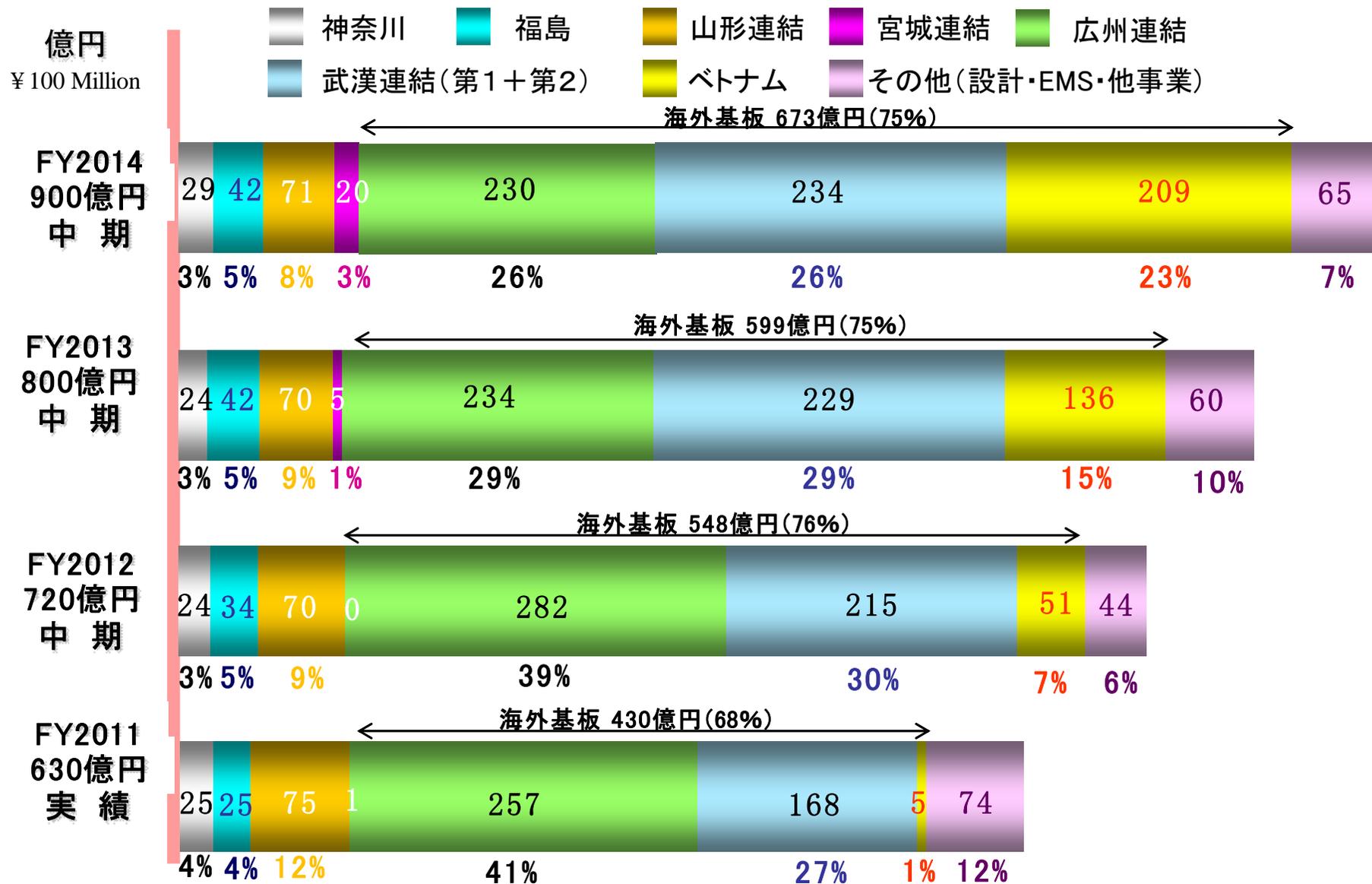
# 4-1 地域別売上計画(基板のみ)

Net sales plan by regions and Customers (PCB only)



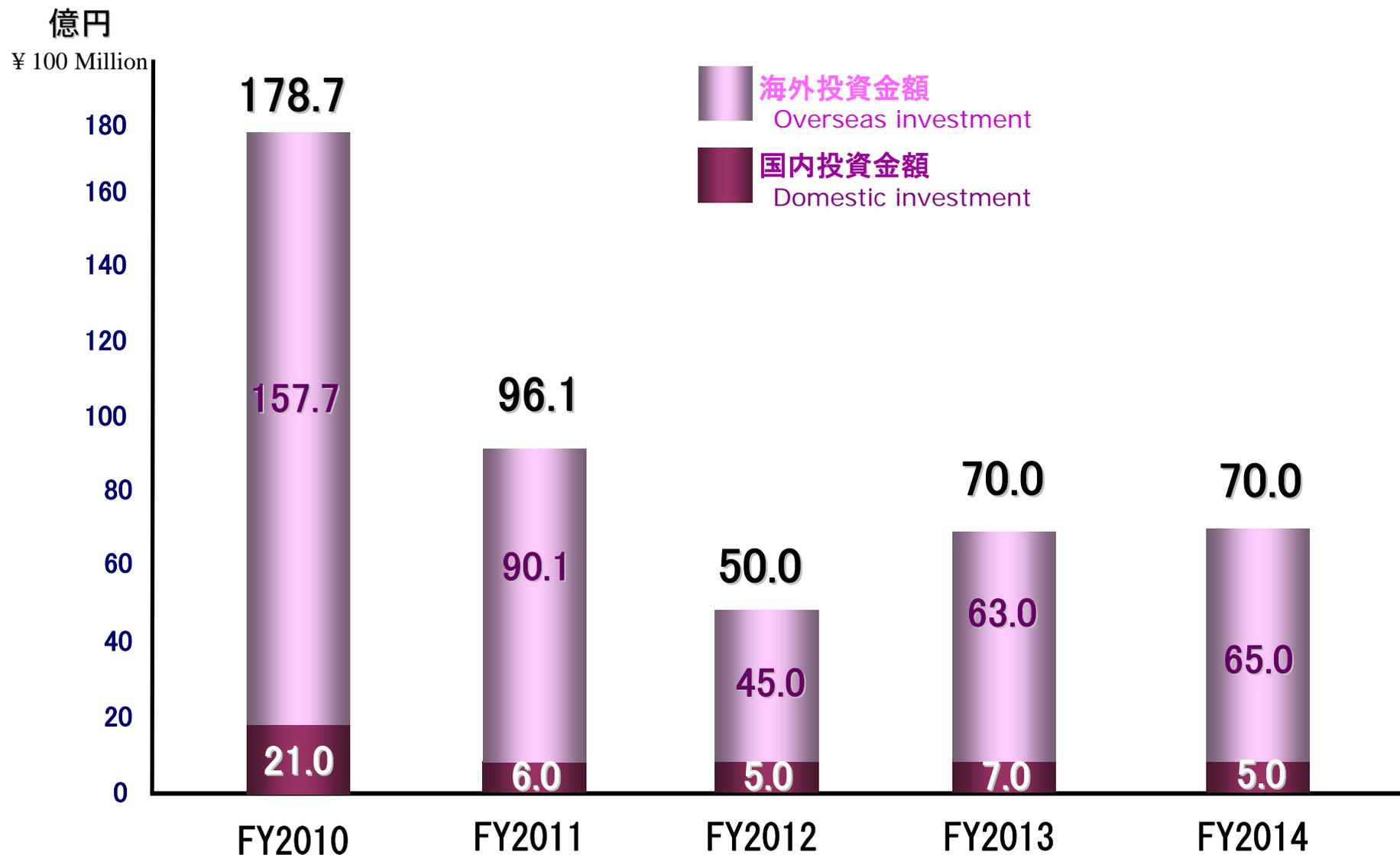
## 4-2 基板工場別売上計画

Net sales plan by production sites



## 4-3 設備投資中期計画

*Capital Investments plan*





株式会社メイコー

<http://www.meiko-elec.com/>

2012年5月22日